



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 603—2006

烧结型银导体浆料

Sintering silver conductive paste

2006-05-25 发布

2006-12-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

中华人民共和国有色金属
行业标准
烧结型银导体浆料

YS/T 603—2006

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话:(010)51299090、68522006

2006年11月第一版

*

书号:155066·2-17206

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录,附录 B 为规范性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人:赵汝云、赵玲、贺东江、陈一、刘林、刘婀娜、马晓峰、黄富春、金勿毁、杜红云、李世鸿、俞守耕。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

烧结型银导体浆料

1 范围

本标准规定了烧结型银导体浆料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及订货单内容。

本标准适用于厚膜混合集成电路、压电陶瓷滤波器及谐振器、圆片陶瓷电容器、真空荧光显示屏、化霜用电极、分立元器件线路引线等用银浆(以下简称银浆)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2424.17	电工电子产品环境试验	锡焊试验导则	
GB/T 17473.1	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	固体含量测定	
GB/T 17473.2	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	细度测定	
GB/T 17473.3	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	方阻测定	
GB/T 17473.4	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	附着力测定	
GB/T 17473.5	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	粘度测定	
GB/T 17473.7	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	可焊性、耐焊性试验	

3 定义

下列定义适用于本标准。

3.1

烧结 sintering

粉料和粒状物料经加热至一定温度范围而粘结成块的过程。烧结时,物发生物理化学变化,同时改变其性质。

3.2

银导体浆料 silver conductive paste

由银粉、无机添加物和有机载体组成的一种满足于印刷特性或涂敷的膏状物。

4 要求

4.1 产品分类及标记示例

4.1.1 烧结型银导体浆料按产品用途共分为:厚膜混合集成电路用银浆;压电陶瓷滤波器、谐振器用银浆;真空荧光显示屏用银浆;化霜用电极银浆;圆片陶瓷电容器用银浆;分立元器件线路引线用银浆等。

4.1.2 厚膜混合集成电路用银浆的牌号标记方法如下: